

证券代码：300656

证券简称：民德电子

## 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上/电话会议
参与单位名称	前海开源基金、景顺长城基金、中天汇富基金、中海基金、大成基金、长城保险、IGWT Investment、德海基金、中大创投、华宝信托、广东正圆基金、上海金友创智基金、循远资管、深圳尚诚资管、玄卜投资、深圳国晖投资、上海睿源基金、元兹投资、西安江岳基金、大博通商投资、深圳熙山资本、共青城鼎睿资管、咸和资管、华创证券、国信证券、财通证券、国海证券、东北证券、东方财富证券
时间	2025年12月17日, 2025年12月19日
地点	公司会议室, 线上会议
上市公司接待人员姓名	董事兼AiDC事业部总经理：高健 董事会秘书：陈国兵 证券事务代表：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司近期重点业务进展情况</b></p> <p><b>1、晶圆代工厂业务进展</b></p> <p>2025年, 功率半导体晶圆代工厂广芯微电子处于良性扩产中: 产品产出从年初的6,000片/月提升到年底的4万片/月, 订单量从年初1万片/月提升到11月的4万片以上, 量产和流片客户从年初的6家增长至目前的十多家(包括几家上市公司及其子公司), 且还有几家新客户在陆续接洽和导入; 目前晶圆厂处于满产状态, 后续将持续稳步扩产。</p> <p>晶圆厂的运营效率和良率也在稳步提升: MOS场效应二极管(MFER)和垂直双扩散金属氧化物半导体场效应晶体管(VDMOS)的平均生产周期较年初缩短了约两周; 产品良率不断提升, 其中MFER产品平均良率从年初的93%提升到目前的98%以上; VDMOS产品, 面向工业与AI数据中心等领域的特高压电源产品平均良率高于95%, 面向消费类电源及电机驱动产品的平均良率达98%以上, 较年初均提升了5%以上。</p> <p>广芯微电子已量产产品包括45-200V的MFER、200-2,000V的VDMOS, 目前已开发计划明年量产的产品包括高压BCD、TVS、IGBT、超级结MOS、FRMOS、FRED、</p>

SBR、高压二极管、恒流管等产品，上述产品可覆盖功率半导体的大部分品类，应用场景包括数据中心电源、电网智能电表、矿机电源、工业电机电源、汽车电子、光伏、消费电子等。

广芯微电子的核心竞争力主要包括两方面：

(1) **纯晶圆代工的商业模式定位：**功率半导体设计公司的痛点，在于找到可以保障其知识产权安全且能为其提供稳定、可靠产能的晶圆代工厂。国内大部分功率半导体晶圆厂都是IDM模式或半IDM模式（一部分自主产品，一部分对外代工），很难做到对客户知识产权的充分保障和产能稳定供应。因此，广芯微的纯晶圆代工模式在行业内相对稀缺，具备原创设计能力的芯片设计公司非常有意愿与广芯微建立代工合作。

(2) **较高端的设备配置和较强的工艺平台能力：**广芯微的设备配置在国内6英寸功率半导体晶圆厂中较为高端，工艺平台能力较强，产品线丰富，尤其在高压、特高压领域具有一定的优势。

## 2、AiDC 业务进展

公司AiDC业务今年仍保持平稳发展，并维持较好的毛利率水平，为公司持续贡献稳定经营性现金流。

## 3、公司投资管理规划及近期主要进展

公司未来的投资，将以晶圆代工产能扩产为主，在其他环节的股权投资应该会较少。此外，对于此前已投资的非核心资产，会考虑在合适的时机出售以收回资金，并获取一定的投资收益。

近期，公司投资方面主要进展有：(1) 公司于2025年11月出售了物流自动分拣设备公司君安宏图的控股权，收回1,480万元股权转让款和300万元借款，减少2,000万元银行授信担保，以及减少了约5千万的应收和约7千万的存货，本次股权转让可优化资源配置、聚焦核心业务发展、提升公司资产运营效率；(2) 特种工艺晶圆代工厂芯微泰克于近期获得了产业合作方数千万的股权融资；(3) 晶圆原材料企业晶睿电子预计将于近期完成约2亿元股权融资，并计划于2026年启动上市筹备工作。

## 二、问答交流

### 1、广芯微电子未来产能规划？

答：广芯微电子一期规划产能为6英寸硅基功率器件月产10万片，预计将于2026

	<p>年底或 2027 年一季度实现满产；同时，广芯微电子已预留二期项目用地，后续会根据一期项目进展情况，适时启动二期项目建设。</p> <p><b>2、广芯微电子目前已量产的产品结构占比如何？高附加值的高压 BCD 和 TVS 产品开发进展情况，以及其它新产品进展情况如何？</b></p> <p>答：（1）广芯微电子已量产产品有 MFER 和 VDMOS，其中 MFER 是最早实现量产的产品，目前月产出约 1.5 万片，其余全部为 VDMOS。（2）瞬态保护二极管 TVS 平台目前已开始量产，700V 高压 BCD 平台工程阶段也取得了重大进展，将在 2026 年释放产能。（3）广芯微电子目前正专注于工业级应用 IGBT 和超快恢复二极管 FRED 产品的工程批开发，并与芯微泰克协同，不断开发先进功率器件特种工艺平台。</p> <p><b>3、广芯微电子生产的车规级产品下游应用主要在哪些方面？</b></p> <p>答：广芯微电子目前代工生产的车规级产品主要应用在非电驱类方面，例如车窗升降器、车辆转向装置、车灯驱动电路等领域。</p> <p><b>4、今年公司大股东减持的原因及进展如何？</b></p> <p>答：公司上市后，三位自然人大股东质押部分股份，用于在二级市场增持民德电子股票；今年公司控股股东许香灿先生和董事、副总经理易仰卿先生提出了股份减持计划，用于偿还质押借款，两人的减持已于 11 月实施完毕。</p> <p><b>风险提示：</b>本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025-12-19